

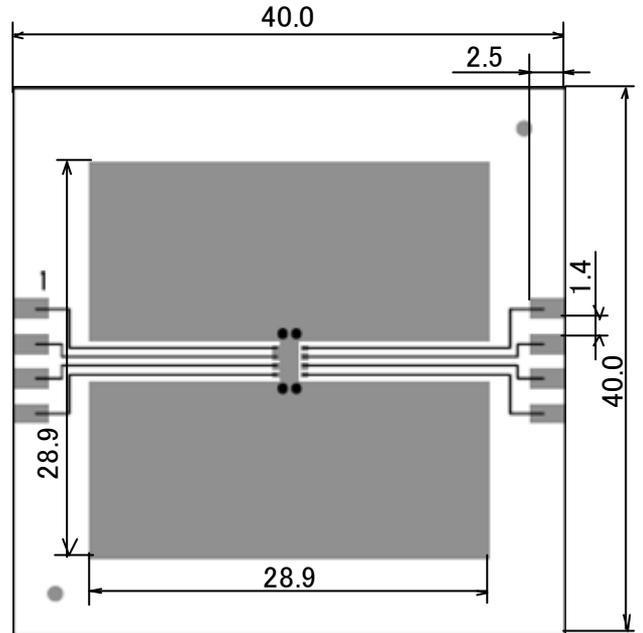
●USP-10B03 パッケージ許容損失

USP-10B03 パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1. 測定条件(参考データ)

- 測定条件： 基板実装状態
- 雰囲気： 自然対流
- 実装： Pb フリーはんだ
- 実装基板： 基板 40mm×40mm (片面 1600mm²) に対して
銅箔面積 表面 約 50%-裏面 約 50%
放熱板と周りの銅箔接続
- 基板材質： ガラスエポキシ (FR-4)
- 板厚： 1.6mm
- スルホール： ホール径 0.8mm 4 個



評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失-周囲温度特性

基板実装(T_{jmax}=125°C)

周囲温度(°C)	許容損失 Pd(mW)	熱抵抗(°C/W)
25	500	200.00
85	200	

